

CONFÉDÉRATION SUISSE
INSTITUT FÉDÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

(11) CH 719 590 A1

Demande de brevet pour la Suisse et le Liechtenstein

Traité sur les brevets, du 22 décembre 1978, entre la Suisse et le Liechtenstein

(51) Int. Cl.: **H05B** 3/36 (2006.01)
H05B 3/14 (2006.01)
B32B 3/10 (2006.01)
B32B 27/40 (2006.01)
F24D 13/00 (2006.01)
G02B 5/02 (2006.01)

(12) **DEMANDE DE BREVET**

(21) Numéro de la demande: 000420/2022

(22) Date de dépôt: 12.04.2022

(43) Demande publiée: 31.10.2023

(71) Requérant:
Graphenaton Technologies SA, Chemin du Pré-Fleuri 3
1228 Plan-les-Ouates (CH)

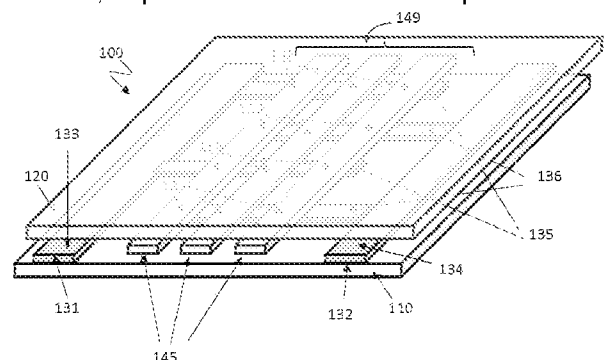
(72) Inventeur(s):
Patrick Muller, 1816 Chailly Montreux (CH)

(74) Mandataire:
Gsmart-IP S.A., Route de Florissant 81
1206 Genève (CH)

(54) **Structure électrothermique multicouches.**

(57) L'invention concerne une structure électrothermique multicouches (100), flexible, sensiblement plane, ayant une face avant destinée à laisser passer des rayons infrarouges et une face arrière opposée à la face avant, la structure ayant une largeur et une longueur, soit une surface. La structure comporte au moins une borne électrique d'entrée (131), au moins une borne électrique de sortie (132) un substrat pour recevoir une pluralité de couches de la structure, le substrat comprend au moins une couche polymérique de substrat (110) au moins une couche électrothermique comportant un élément résistif (149) ayant une entrée et une sortie; et au moins une couche conductrice pour connecter la borne d'entrée (131) de la structure à l'entrée de l'élément résistif (149) et la borne de sortie (132) de la structure à la sortie de l'élément résistif (149). La structure (100) est recouverte d'une passivation comprenant au moins une couche polymérique de passivation (120). La couche électrothermique comporte une pluralité de bandes isolées (145), longiformes, d'une matière électrothermique, lesdites bandes étant agencées pour être interconnectées entre elles pour créer ledit élément résistif. La couche conductrice comporte une matière conductrice qui est formée et connectée pour éclater l'entrée de l'élément résistif sur une pluralité de points d'entrée (138) sur la longueur d'une première des bandes électrothermiques ainsi que sur une pluralité de points d'entrée correspondants (138) sur la longueur des bandes électrothermiques restantes et pour consolider la sortie de l'élément résistif à partir d'une pluralité de points de sortie (139) sur la longueur de la première des bandes électrother-

miques ainsi qu'à partir d'une pluralité de points de sortie correspondants (139) sur la longueur des bandes électrothermiques restantes, les points de sortie sont distincts des points d'entrée.



Description

DOMAINE TECHNIQUE

[0001] La présente invention porte sur des films chauffants par résistance ohmique. Plus particulièrement, l'invention concerne des éléments chauffants ayant une surface s'étendant essentiellement dans deux dimensions dans lesquels le conducteur est monté sur une base isolante et recouvert d'un matériau isolant.

ÉTAT DE LA TECHNIQUE

[0002] La demande de brevet internationale, publiée sous le numéro 2013/179341A1 décrit un film chauffant comprenant un élément chauffant plan qui présente une paire de bornes, une paire de fils conducteurs soudés aux bornes et deux feuilles de film polyamide thermoplastique qui sont respectivement stratifiées sur les surfaces de l'élément chauffant plan par soudage thermique et qui maintiennent ledit élément chauffant plan dans un état étanche. Dans le film chauffant, les films de polyamide thermoplastique peuvent être soudés de manière hermétique par soudage thermique sur l'élément chauffant plan de manière à l'étanchéifier.

[0003] Les principaux problèmes des solutions connues sont des mises en oeuvre compliquées et des consommations élevées pour une utilisation primaire à savoir le chauffage. Un autre problème est la gestion de la chaleur dans les films chauffants existants.

RÉSUMÉ DE L'INVENTION

[0004] Un but de la présente invention est de proposer une solution de chauffage qui soit plus rapide à mettre en oeuvre. Un autre but est de proposer une solution simplifiée d'un film chauffante autorégulé. Il est aussi un but de la présente invention de proposer des films chauffants qui soient plus simples à produire en usine, avec des procédés de fabrications plus efficaces.

[0005] Selon un premier aspect, un film chauffant est présenté. Il s'agit d'une structure électrothermique multicouches, qui est flexible et qui est sensiblement plane. Dans au moins un mode de réalisation la structure peut être enroulée sur elle-même. La structure comporte une face avant destinée à laisser passer des rayons infrarouges et une face arrière opposée à la face avant. La structure a une certaine largeur et une certaine longueur, soit une surface. Dans au moins un mode de réalisation, la structure est nettement plus large qu'elle est longue et peut être déployer dans de grands rouleaux. Selon un mode de réalisation, la structure comporte : au moins une borne électrique d'entrée ; au moins une borne électrique de sortie ; un substrat pour recevoir une pluralité de couches de la structure, le substrat comprenant au moins une couche polymérique de substrat ; au moins une couche électrothermique comportant un élément résistif ayant une entrée et une sortie ; et au moins une couche conductrice pour connecter :

la borne d'entrée de la structure à l'entrée de l'élément résistif ; et

la borne de sortie de la structure à la sortie de l'élément résistif ;

la structure étant recouverte d'une passivation comprenant au moins une couche polymérique de passivation. Avantageusement, la couche électrothermique comporte une pluralité de bandes isolées, longiformes, d'une matière électrothermique, lesdites bandes étant agencées pour être interconnectées entres elles pour créer ledit élément résistif ; et la couche conductrice comporte une matière conductrice qui est formée et connectée pour :

1. éclater l'entrée de l'élément résistif sur une pluralité de points d'entrée sur la longueur d'une première des bandes électrothermiques ainsi que sur une pluralité de points d'entrée correspondants sur la longueur des bandes électrothermiques restantes ; et
2. consolider la sortie de l'élément résistif à partir d'une pluralité de points de sortie sur la longueur de la première des bandes électrothermiques ainsi qu'à partir d'une pluralité de points de sortie correspondants sur la longueur des bandes électrothermiques restantes, les points de sortie étant distincts des points d'entrée.

[0006] Dans un mode préféré de réalisation, le substrat comporte deux couches d'isolant et la passivation comporte également deux couches d'isolant. La couche chauffante est encapsulée entre la passivation et le substrat, préférablement par un procédé de lamination à chaud, ainsi rendant les structures électrothermiques multicouches proposés par la présente invention étanche à l'eau et à l'air. Par le même, ces structures présentent une grande protection contre des éventuelles endommagements par action mécanique, tels des griffures et / ou des coupures. Les structures électrothermiques multicouches offrent aussi une bonne isolation électrique.

[0007] Répondant aux exigences de standards de la construction tels que les normes RT2020, la MOPEC en Suisse ou les NF EN 60335-1 et NF EN 60335-2-96 en relation avec les appareils électrodomestiques et les films rayonnants, ces structures peuvent être utilisées dans le domaine du chauffage domestique.

DESCRIPTION SOMMAIRE DES DESSINS

[0008] Les caractéristiques de l'invention apparaîtront plus clairement à la lecture de la description de plusieurs formes d'exécution données uniquement à titre d'exemple, nullement limitative en se référant aux figures schématiques, dans lesquelles :

- La figure 1 montre les différentes couches présentes dans une structure électrothermique selon un mode de réalisation décrit dans le présent document ;
- La figure 2 illustre un schéma électrique équivalent représentant une couche électrothermique qui peut être déployée dans un mode de réalisation de la structure électrothermique ;
- La figure 3 montre une vue des couches employées dans une structure électrothermique selon un mode de réalisation ;
- La figure 4 montre les couches présentes dans une structure électrothermique selon un autre mode de réalisation ; et
- La figure 5 montre les couches présentes dans une structure électrothermique selon encore un autre mode de réalisation.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'INVENTION

[0009] La présente invention concerne une structure électrothermique multicouches qui comporte un élément chauffant par l'effet Joule. L'élément chauffant comporte un matériau électrothermique, qui chauffe lorsqu'il conduit un courant électrique. Selon un mode de réalisation, le matériau électrothermique a un coefficient de température positive (PTC). Selon un mode de réalisation, le matériau a une émissivité tel qu'en chauffant, il se met à émettre de la radiation infrarouge, préférablement de l'infrarouge lointain. Ainsi, la structure électrothermique de la présente invention chauffe par l'effet de la radiation infrarouge plutôt que par convection. Le choix de rayonnement infrarouge lointain (far infra-red) est fait pour favoriser la sensation de chaleur ressenti par un être humain, car le corps humain favorise l'absorption de radiation dans ce spectre.

[0010] De préférence, la structure électrothermique de la présente invention est sensiblement plane, s'étendant dans deux dimensions. La structure est longiforme de préférence, ayant une longueur plusieurs fois plus importante que sa largeur. Selon un mode de réalisation, la structure électrothermique a une certaine souplesse tel qu'elle est suffisamment flexible pour être enroulée sur elle-même. Les structures de la présente invention sont donc faciles à manipuler et à transporter.

[0011] Les matériaux choisis pour l'encapsulation de la structure, soit le substrat et la passivation, sont choisis pour laisser passer les rayons infrarouges. De préférence, au moins une de deux surfaces laisse passer les rayons infrarouges. Dans un mode de réalisation, une couche réfléchissante est utilisée pour favoriser le passage des rayons infrarouges par une seule face de la structure, soit la face dite la face avant, plutôt que par la face arrière. Dans d'autres modes de réalisation, les rayons infrarouges peuvent passer par la face avant et la face arrière de la structure.

[0012] La figure 1 montre les couches qui peuvent être présents dans une structure électrothermique 100 selon un mode de réalisation de l'invention. La structure est construite sur une base, soit le substrat 110. Selon un mode de réalisation, le substrat est fait d'une couche de matériau polymère flexible, par exemple le polyéthylène téréphtalate (PET). Une couche conductrice 130 vient ensuite. Selon un mode de réalisation de l'invention, la couche conductrice est une encre conductrice, déposée par un procédé de „slot dies“ puis séchée par rayonnement infrarouge, ce qui favorise un séchage rapide. Optionnellement, pour faciliter l'accrochage de l'encre à la couche polymérique du substrat, le substrat subit un traitement plasma. Dans un autre mode de réalisation, une couche d'apprêt peut être appliqué sur le substrat au lieu d'utiliser le traitement plasma pour assurer l'accrochage de la couche conductrice sur le substrat.

[0013] Sur la couche conductrice est dessiné, en encre conductrice, un certain nombre de conducteurs de courant pour amener un courant qui arrive sur une paire de bornes 131 132, entrée / sortie, situées préférablement vers un bord de la structure, au moins vers l'élément chauffant de la structure. La figure 2 montre un schéma électrique qui représente l'élément chauffant 149 de la structure 100, avec ses bornes d'entrée 131 et sortie 132. L'élément chauffant est représenté par une résistance 149.

[0014] Selon la mode de réalisation décrit ci-dessus, l'élément chauffant se trouve dans la couche électrothermique, qui est dénotée 140 dans la figure 1. L'élément chauffant peut avoir n'importe quelle forme pour autant qu'il présente une résistance suffisante pour produire l'effet Joule souhaité. Grâce aux propriétés d'émissivité du matériau électrothermique choisi comme élément chauffant, ses dimensions vont dicter la température, en fonction du courant, et la quantité de rayonnement infrarouge produit. Le matériau électrothermique de l'élément chauffant peut être déposé par un procédé de sérigraphie, comme la couche conductive, de préférence par un procédé de slot dies. Des contacts entre le matériau électrothermique de la couche électrothermique et le matériau conducteur de la couche conductive se font aux endroits où les deux matériaux se touchent, ainsi créent la résistance, représentée schématiquement dans la figure 2. La résistance à

une entrée et une sortie. Dans un mode de réalisation, l'entrée de la résistance est reliée à la borne d'entrée de la structure et la sortie de la résistance est reliée à la borne de sortie de la structure.

[0015] Comme indiqué dans la figure 1, la dernière couche est une couche de passivation 120. La couche de passivation peut être faite du même matériau que la couche de substrat, soit un polymère flexible, de préférence laissant passer des rayons infrarouges. Selon un mode de réalisation, la couche de passivation est en polyéthylène téréphtalate (PET). Selon un mode de réalisation, une couche de colle est utilisée pour fixer la couche de passivation sur la couche électrothermique. Ainsi une structure dite „sarcophage“ assure l'étanchéité à l'air et à l'eau pour protéger l'élément chauffant et les conducteurs électriques.

[0016] Selon un mode de réalisation, la colle est une colle en polyuréthane, traitée à chaud. La colle en polyuréthane peut être déposée en phase liquide. Selon un autre mode de réalisation, la colle est solide, par exemple une colle „PSA“ (pression sensitive adhésive), l'adhésion fonctionnant en appliquant une pression mécanique.

[0017] La figure 1 montre l'ordre des couches en commençant du bas vers le haut avec la couche de substrat 110, la couche conductrice 130, la couche électrothermique 140 et la couche de passivation 120. Dans d'autres modes de réalisation, il est possible de changer l'ordre, par exemple : substrat 110, électrothermique 140, conductrice 130, passivation 120 ; ou passivation 120, conductrice 130, électrothermique 140, substrat 110 ; ou encore passivation 120, électrothermique 140, conductrice 130, substrat 110.

[0018] Selon un mode de réalisation, la radiation passe par une face de la structure, soit par la passivation, soit par le substrat. Dans ce mode de réalisation, la structure comporte une couche réfléchissante pour réfléchir les rayons infrarouges lointains vers un des deux surfaces, soit la face avant. L'autre face est la face arrière. La couche réfléchissante est faite en aluminium selon un mode de réalisation préféré et est placée vers la face arrière.

[0019] Selon un mode préféré de réalisation, le substrat comporte deux couches polymériques de substrat, collées ensemble. La passivation peut aussi comporter deux couches polymériques de passivation collées ensemble. Ainsi, la structure donne une bonne isolation électrique ainsi qu'une protection mécanique contre les griffures ou d'autres dégradations de la surface. Le fait d'avoir deux couches collées ensemble offre une meilleure protection mécanique qu'une seule couche ayant une épaisseur doublée, parce que la couche de colle offre une barrière pour arrêter la propagation d'une éventuelle coupure ou déchirure dans une couche polymérique.

[0020] Les couches polymériques (de substrat ou de passivation) peuvent être faites en PET selon un mode préféré de réalisation mais peuvent également être faites en polyéthylène (PE), polypropylène (PP), polychlorure de vinyle (PVC), PVC souple (PVC-P), polystyrène (PS), polycarbonate (PC), polyméthacrylate de méthyle (PMMA), polyoxyméthylène (POM), polytéréphtalate d'éthylène (PET), polyester, co-polyester, polyétheréthercétone (PEEK), polyamide, notamment le polyamide 6 (PA6), le polyamide 12 (PA12), le polyamide 10, le polyamide 610, le polyamide 66, le polyamide à base de constituants aliphatiques et cycloaliphatiques tels que notamment MACM12 ou le co-polyamide amorphe, de préférence à base de PA12, ou des copolymères ou mélanges de ceux-ci.

[0021] La température du matériau électrothermique est réglée en contrôlant les dimensions physiques de l'élément électrothermique, soit son épaisseur, sa largeur et sa longueur. L'épaisseur est contrôlée par la méthode de dépôt de la couche électrothermique. Le procédé de slot die est favorisé car il permet un bon contrôle de l'épaisseur.

[0022] La figure 3 montre un exemple de la structure selon un mode de réalisation. Pour assurer une bonne, uniforme, répartition de la chaleur sur la surface de la structure, dans un mode de réalisation préféré, l'élément résistif est créé en reliant une pluralité de bandes d'une certaine largeur connectées en parallèle par des fils conducteurs dans la couche conductrice. La largeur et l'épaisseur du matériau électrothermique sont ainsi contrôlées. Pour contrôler aussi la longueur, on amène le courant, par le conducteur de la couche conductrice sur un point d'entrée sur la bande électrothermique et on récupère du courant à un point de sortie à une distance D du point d'entrée. Ceci est répété sur la longueur de la bande de matériau électrothermique. Cette technique est répétée sur toute les bandes électrothermiques.

[0023] Le courant est donc amené d'un côté de la structure, par un conducteur parallèle aux bandes longiforme de matériau électrothermique et sorti par un autre conducteur parallèle sur l'autre côté de la structure. Pour accéder aux points d'entrée de courant sur chaque bande, des extensions sont formées sur le conducteur, en peigne. D'autres extensions sont fournies pour récupérer le courant pour le conducteur de sortie. Les peignes d'entrée et sorties peuvent être intercalés. Le résultat est que les bandes de matériau électrothermiques sont connectées en beaucoup de résistances en parallèle, les dimensions étant bien contrôlées et leur répartition sur toute la surface est aussi bien contrôlé. Lorsque la structure est utilisée comme film chauffant, la chaleur est donc bien contrôlée et sa répartition sur toute la surface est bien gérée.

[0024] L'élément résistif peut contenir du carbone, préférentiellement du graphène. Le graphène peut être une forme de graphène dite microparticules de graphène, préférentiellement dans une forme de nanoparticules (par exemple 1nm - 100nm) de graphène, soit des nanotubes, soit des nano-sphères, soit des nano-fils de graphène. Cette forme de graphène est préférée pour les procédés de sérigraphie, notamment le slot dies pour ne pas bloquer les bords de sortie d'encre. Le frittage peut être fait à des températures suffisamment basses pour ne pas endommager les couches polymériques. Les conducteurs peuvent être faits en argent, cuivre ou graphène.

Revendications

1. Structure électrothermique multicouches (100), flexible, sensiblement planaire, ayant une face avant destinée à laisser passer des rayons infrarouges et une face arrière opposée à la face avant, la structure ayant une largeur et une longueur, soit une surface, la structure (100) comportant :
au moins une borne électrique d'entrée (131) ;
au moins une borne électrique de sortie (132) ;
un substrat pour recevoir une pluralité de couches de la structure, le substrat comprenant au moins une couche polymérique de substrat (110) ;
au moins une couche électrothermique (140) comportant un élément résistif (149) ayant une entrée et une sortie ; et
au moins une couche conductrice (130) pour connecter :
la borne d'entrée (131) de la structure à l'entrée de l'élément résistif (149) ; et
la borne de sortie (132) de la structure à la sortie de l'élément résistif (149) ;
la structure (100) étant recouverte d'une passivation comprenant au moins une couche polymérique de passivation (120) ;
caractérisé en ce que :
la couche électrothermique (140) comporte une pluralité de bandes isolées (145), longiformes, d'une matière électrothermique, lesdites bandes (145) étant agencées pour être interconnectées entre elles pour créer ledit élément résistif (149) ; et
la couche conductrice (130) comporte une matière conductrice qui est formée et connectée pour :
éclater l'entrée de l'élément résistif (149) sur une pluralité de points d'entrée (138) sur la longueur d'une première des bandes électrothermiques (145) ainsi que sur une pluralité de points d'entrée correspondants (138) sur la longueur des bandes électrothermiques restantes (145) ; et
consolider la sortie de l'élément résistif (149) à partir d'une pluralité de points de sortie (139) sur la longueur de la première des bandes électrothermiques (145) ainsi qu'à partir d'une pluralité de points de sortie correspondants (139) sur la longueur des bandes électrothermiques restantes (145), les points de sortie (139) étant distincts des points d'entrée (138).
2. Structure (100) selon la revendication 1, dans laquelle les points d'entrée (138) de l'élément résistif (149) sont intercalées avec les points de sortie (139) de l'élément résistif (149) sur la longueur de chacune des bandes électrothermiques (145).
3. Structure (400, 500) selon l'une quelconque des revendications 1 ou 2, dans laquelle le substrat comporte une pluralité de couches polymériques de substrat (110, 111) collées entre elles et / ou la passivation comporte une pluralité de couches polymériques de passivation (120, 121) collées entre elles.
4. Structure (400, 500) selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans laquelle la structure comporte en outre une couche réfléchissante d'ondes infrarouge lointains (170) pour renvoyer au moins les ondes infrarouges lointains de la face arrière vers la face avant de la structure.
5. Structure (400, 500) selon la revendication 4, dans laquelle la couche réfléchissante (170) se situe entre la couche électrothermique (140) et la face arrière de la structure, la couche réfléchissante (170) étant collée sur une couche polymérique (110, 120) ou entre deux couches polymériques (110, 111, 120, 121).
6. Structure (100, 400, 500) selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle la couche conductrice (130) se trouve entre la couche électrothermique (140) et le substrat (110, 111), ladite couche conductrice (130) étant collée au substrat (110, 111) et ladite couche électrothermique étant collée à la passivation (120, 121).
7. Structure (100, 400, 500) selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, dans laquelle la couche conductrice (130) se trouve entre la couche électrothermique (140) et la passivation (120, 121), ladite couche conductrice étant collée à la passivation (120, 121) et ladite couche électrothermique (140) étant collée au substrat (110, 111).
8. Structure (100, 400, 500) selon l'une des revendications 6 ou 7, dans laquelle une couche d'apprêt est intercalée entre la couche conductrice (130) et le substrat (110, 111) ou entre la couche conductrice (130) et la passivation (120, 121).
9. Structure (100, 400, 500) selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle lesdites collages entre couches sont faites à l'aide d'une colle en polyuréthane.
10. Structure (100, 400, 500) selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle la longueur des bandes électrothermiques (145) est égale à, ou moins que, la longueur de la structure (100, 400, 500), la pluralité de bandes électrothermiques (145) recouvrant sensiblement toute la surface de la structure (100, 400, 500).
11. Structure (100, 400, 500) selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle l'élément résistif (149) comporte du carbone, préférablement du graphène, préférablement dans une forme de microparticules de graphène, préférablement dans une forme de nanoparticules de graphène, soit des nanotubes, soit des nano-sphères, soit des nano-fils de graphène.
12. Structure (100, 400, 500) selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle la couche conductrice (130) comporte, comme matière conductrice, du cuivre, de l'or, de l'argent, du nickel ou de la platine.

13. Structure (400, 500) selon l'une quelconque des revendications 4 à 12, dans laquelle la couche réfléchissante (170) comporte de l'aluminium qui recouvre sensiblement toute la surface de la structure.
14. Structure (100, 400, 500) selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle les couches polymériques (110, 111, 120, 121) sont en polyéthylène téréphtalate (PET) (polyéthylène (PE), le polypropylène (PP), le polychlorure de vinyle (PVC), le PVC souple (PVC-P), le polystyrène (PS), le polycarbonate (PC), le polyméthacrylate de méthyle (PMMA), le polyoxyméthylène (POM), le polytéréphtalate d'éthylène (PET), le polyester, le co-polyester, la polyétheréthercétone (PEEK), le polyamide, notamment le polyamide 6 (PA6), le polyamide 12 (PA12), le polyamide 10, le polyamide 610, le polyamide 66, le polyamide à base de constituants aliphatiques et cycloaliphatiques tels que notamment MACM12 ou le co-polyamide amorphe, de préférence à base de PA12, ou des copolymères ou mélanges de ceux-ci.
15. Structure (100, 400, 500) selon l'une quelconque des revendications précédentes, la structure étant enroulable.

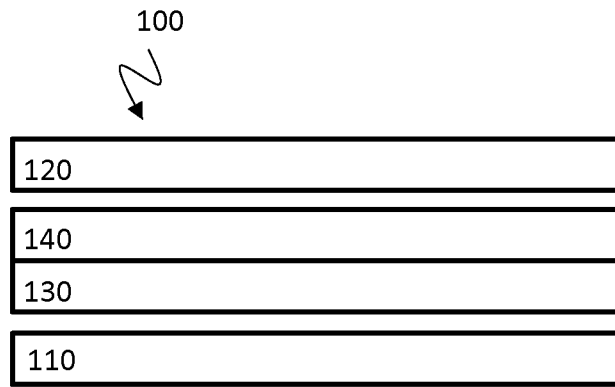


FIG. 1

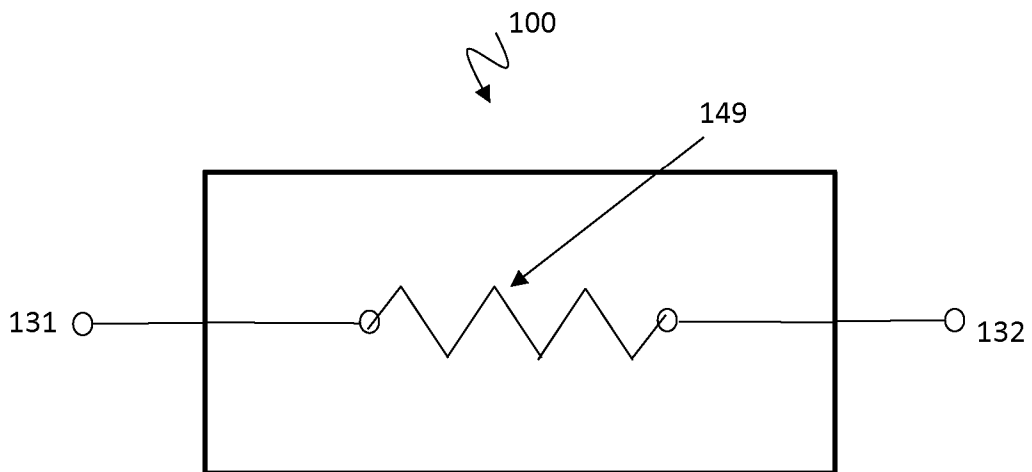


FIG. 2

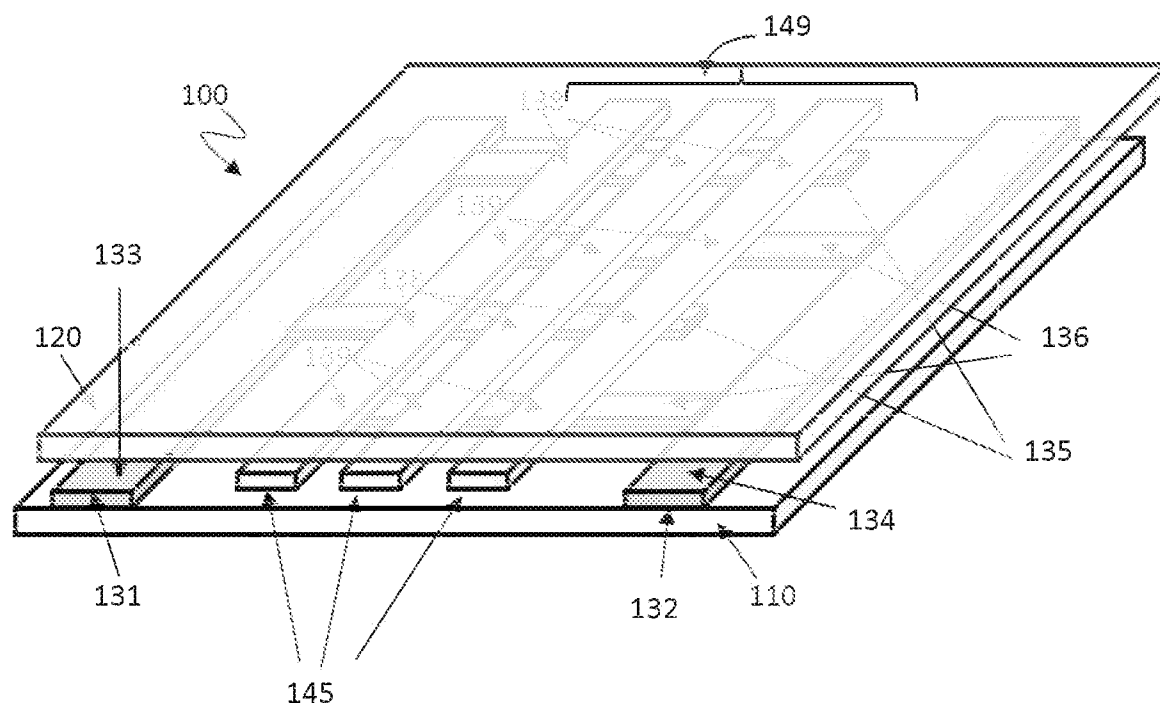


FIG. 3

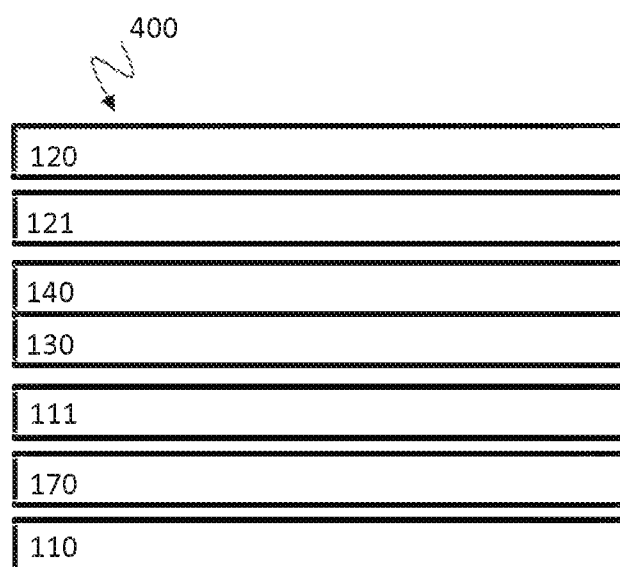


FIG. 4

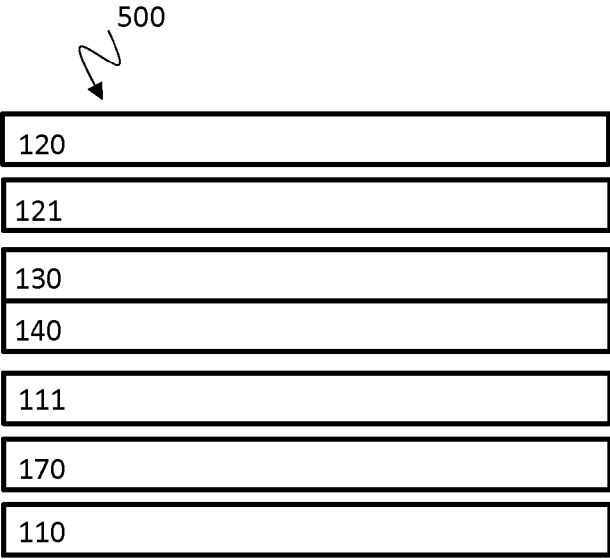


FIG. 5

**RAPPORT DE RECHERCHE RELATIF À LA
DEMANDE DE BREVET SUISSE**

Numéro de la demande: CH00420/22

Classification de la demande (CIB):
H05B3/36, H05B3/14, B32B3/10, B32B27/40,
F24D13/00, G02B5/02

Domaines recherchés (CIB):
 B32B, H05B

DOCUMENTS PERTINENTS:

(référence du document, catégorie, revendications concernées, indications des parties significatives (**))

- 1 US2021134496 A1 (LMS CONSULTING GROUP LLC [US]) 06.05.2021
 Catégorie: **X** Revendications: **1 - 8, 11 - 12, 14**
 Catégorie: **Y** Revendications: **9, 13**
 * [0011]; [0039]; [0094]; [0096] - [0097]; [0100]; [0102]; [0111]; [0125]; [0132]; [0151];
 Figures 2 - 5, 18; *
- 2 US2010065542 A1 (UNITED STATES GYPSUM CO [US]) 18.03.2010
 Catégorie: **X** Revendications: **1, 3, 8, 10 - 12, 14**
 * [0052]; [0054] - [0056]; [0058]; [0060]; [0071]; [0073]; Figures 1 -16; *
- 3 US2018335218 A1 (UNITED STATES GYPSUM CO [US]) 22.11.2018
 Catégorie: **X** Revendications: **1 - 2, 11 - 12, 14 -15**
 * [0028]; [0036] - [0037]; [0043]; Figures 6, 8 - 10; *
- 4 US2010213189 A1 (TESA SE [DE]) 26.08.2010
 Catégorie: **Y** Revendications: **9**
 * Revendications 3, 4; *
- 5 US6229123 B1 (THERMOSOFT INTERNAT CORP [US]) 08.05.2001
 Catégorie: **Y** Revendications: **13**
 * Colonne 7, Lignes 23 - 28 *

CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS:

X:	remettent en question, à eux seuls, la nouveauté et/ou l'activité inventive	D:	ont été fournis par le demandeur avec la demande de brevet
Y:	remettent en question, à l'appui d'un document de la même catégorie, l'activité inventive	T:	théories et principes sur lesquels se fonde l'invention
A:	définissent l'état général de la technique sans avoir de pertinence particulière pour la nouveauté et l'activité inventive	E:	documents de brevets dont la date de dépôt ou de priorité se situe avant la date de dépôt de la demande de brevet objet de la recherche mais qui ont été publiés seulement après cette date
O:	divulgaration non écrite	L:	documents cités pour d'autres raisons
P:	ont été publiés entre la date de dépôt de la demande de brevet objet de la recherche et la date de priorité revendiquée	&:	membre de la même famille de brevets; document correspondant

La recherche se base sur la version des revendications déposée initialement. Une nouvelle version des revendications déposée ultérieurement (art. 51 al. 2 OBI) n'est pas prise en considération.

Le présent rapport de recherche a été établi pour les revendications, pour lesquelles les taxes requises ont été payées.

Recherche effectuée par:	Roberto Ortuso
Autorité de recherche, lieu:	Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Berne
Fin de la recherche:	27.01.2023

TABLEAU DES FAMILLES DES BREVETS CITÉS

Les membres de la famille sont mentionnés conformément à la base de données de l'Office européen des brevets. L'Office européen des brevets et l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle ne garantissent pas ces données. Celles-ci sont fournies uniquement à titre d'information.

US2021134496 A1	06.05.2021	US2021134496 A1	06.05.2021
		US11302463 B2	12.04.2022
US2010065542 A1	18.03.2010	US2022199295 A1	23.06.2022
		WO2010033547 A2	25.03.2010
		WO2010033547 A3	24.06.2010
		CN102160455 A	17.08.2011
		EP2335451 A2	22.06.2011
		JP2012503163 A	02.02.2012
		JP2012503275 A	02.02.2012
		NZ591295 A	26.10.2012
		US2010065543 A1	18.03.2010
		US8618445 B2	31.12.2013
		CO6501142 A2	15.08.2012
		EP2334991 A2	22.06.2011
		MX2011002661 A	21.04.2011
		BRPI0913525 A2	27.03.2018
		AU2009293323 A1	25.03.2010
		CA2735603 A1	25.03.2010
		ZA201101488 B	26.10.2011
		WO2010033548 A2	25.03.2010
		WO2010033548 A3	08.07.2010
		CN102159895 A	17.08.2011
		KR20110053486 A	23.05.2011
		RU2011106817 A	27.10.2012
		RU2011107398 A	27.10.2012
		US2010065542 A1	18.03.2010
		US8039774 B2	18.10.2011
		MX2011002662 A	10.05.2011
		BRPI0913526 A2	27.03.2018
		KR20110070866 A	24.06.2011
		CA2735664 A1	25.03.2010
		AU2009293324 A1	25.03.2010
US2018335218 A1	22.11.2018	MX2019013472 A	13.02.2020
		WO2018213398 A1	22.11.2018
		JP2020521280 A	16.07.2020
		CA3063708 A1	22.11.2018
		US2018335218 A1	22.11.2018
US2010213189 A1	26.08.2010	US10775050 B2	15.09.2020
		EP2224784 A1	01.09.2010
		EP2224784 B1	09.05.2012
		CN101848565 A	29.09.2010
		CN101848565 B	31.07.2013
		ES2386762T T3	29.08.2012
		DE102009010437 A1	02.09.2010
		KR20100097629 A	03.09.2010
		KR101650440 B1	23.08.2016
		JP2010199071 A	09.09.2010

CH 719 590 A1

		JP5539752 B2	02.07.2014
		AT557572T T	15.05.2012
		US2010213189 A1	26.08.2010
		US8283612 B2	09.10.2012
		RU2010107095 A	27.08.2011
		MX2010001984 A	25.08.2010
US6229123 B1	08.05.2001	US2001002669 A1	07.06.2001
		US6369369 B2	09.04.2002
		US6229123 B1	08.05.2001